# $Al_2O_3$ -불수강판형담체에서 린산에 의한 $Al_2O_3$ 층의 부착세기개선

최영길, 리종과, 리선일

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《에네르기와 철강재, 화학제품, 식량문제를 비롯하여 현시기 경제강국건설에서 관건적의의를 가지는 문제들을 과학기술적으로 해결하는데 주되는 힘을 넣어야 합니다.》 (《조선로동당 제7차대회에서 한 중앙위원회사업총화보고》단행본 41폐지)

 $Al_2O_3$ -불수강담체촉매는 발전계통의 안전운영에 널리 리용되는 촉매이다. 금속재료를 지지체로 쓰려면 금속표면에 촉매물질이나 담체물질을 견고히 부착시켜야 하는데 우리는  $\gamma$ - $Al_2O_3$ 을 해교하여 불수강판에 피복하는 방법으로  $Al_2O_3$ -불수강판형담체를 제조하였다.[1] 강철판에 입힌 알루미나충을 린산알루미니움으로 처리하여 부착세기를 높일수 있다.[3]

론문에서는 선행연구[1]의 방법으로 만든 담체를 린산으로 처리하여  $Al_2O_3$ 층의 부착세기를 더 높이기 위한 방도에 대하여 서술하였다.

## 실 험 방 법

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-불수강판형담체시편은 선행연구[1]의 방법으로 만들었다. 촉매기판(두께 0.3mm) 인 불수강판을 비누물, 30% 질산과 메타놀로 세척하여 기름기와 기타 오염물들을 제거한 다음 연마지 또는 연마석으로 연마하여 표면을 거칠게 하고 500℃에서 공기중에서 3h동안 가열하는 방법으로 표면을 처리하였다. 한편 비표면적이 280m²/g인 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>을 행성식볼밀에서 메타놀매질속에서 분쇄하고 건조하여 립도 1μm이하의 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>분말을 얻은 다음 HNO<sub>3</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=2mmol/g, H<sub>2</sub>O/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=2(질량비)의 매질에서 16h동안 세계 교반하여 해교하는 방법으로 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>졸을 만들었다. 얻어진 γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>졸을 표면처리한 불수강판에 바르고 수직으로 세워 흘러내린 부분을 제거한 다음 110℃에서 3h 건조하고 500℃에서 3h 소성하였다.

얻어진  $Al_2O_3$ -불수강판형담체시편의 린산처리는 해당한 농도의 린산수용액으로 시편을 적시고  $110^{\circ}$ C에서 1h 건조한 다음 해당한 온도에서 3h 소성하는 방법으로 진행하였다.

불수강표면에 입혀진  $\gamma$ - $Al_2O_3$ 의 량은 천평에서 0.1mg의 정확도로 평량하여 결정하였으며 입혀진  $\gamma$ - $Al_2O_3$ 층의 두께는 선행연구결과[2]에 근거하여 그 밀도를  $1g/cm^3$ 로 보고 계산의 방법으로 결정하였다.

불수강표면에 입혀진  $Al_2O_3$ 층의 부착세기는 시편을 물매질에서 주파수 40kHz, 출력 100W의 초음파로  $10min동안 처리하고 떨어져나가지 않은 <math>\gamma-Al_2O_3$ 의 량을 비교하는 방법으로 상대적으로 평가하였다.

알루미나-린산혼합물의 소성때 반응진행 및 새 상의 형성여부를 열무게분석기(《TGA-50H》), 시차열분석기(《DTA-50》), X선회절분석기(《Rigaku SmartLab》)와 푸리에변환적외선분광기(《NICOLET 6700》)로 관찰하였다.

#### 실험결과 및 해석

 $\gamma$ — $Al_2O_3$ 층의 부착세기에 미치는 린산처리조건의 영향 선행연구[1]의 방법대로 우에서 지적한 조건에서 만든  $Al_2O_3$ —불수강판형담체시편들에서 알루미나층의 두께는  $17\mu$ m정도였으며 부착세기는 우의 방법대로 초음파처리하고 남은 량이 85%로서 그리 센편이 아니였다.

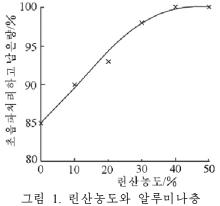


그림 1. 린산농도와 알루미나층 의 부착세기와의 관계 소성온도 500℃

이 시편들을 각이한 농도의 린산수용액으로 적시고 110℃에서 1h 건조하고 500℃에서 3h 소성하는 방법으로 린산처리를 진행한 다음 부착세기를 측정하였다. 그 결과 린산의 농도와 부착세기와는 그림 1과 같은 관계에 있었다.

그림 1에서 보는바와 같이 린산으로 처리하면 알루미나층의 부착세기가 올라가며 린산농도가 40%이면 최대로 된다는것을 알수 있다.

다음 시편을 린산으로 적시고 건조한 후의 합리적 인 소성온도를 알기 위하여 부착세기와 소성온도와의 관계를 보았다.(그림 2) 린산의 농도는 40%로 하였다.

그림 2에서 보는바와 같이 소성온도 200℃이상에

서부터 부착세기가 높아지고 소성온도 300℃이상에서 는 온도에 따르는 변화가 거의 없었다.

이상을 종합해보면  $Al_2O_3$ -불수강판형담체를 40%의 린산수용액으로 적시고  $110^{\circ}$ C에서 1h 건조한 다음  $300^{\circ}$ C에서 3h 소성하는 방법으로 린산처리를 하면 알루미나층의 부착세기가 훨씬 높아진다는것을 알수 있다. 현상적으로는 이 방법으로 부착세기가 보강된  $Al_2O_3$ -불수강판형담체는 칼로 세게 긁어도 부착층이떨어지지 않을 정도로 부착세기가 보장된다는것을 알수 있다. 결국 불수강판표면의 알루미나층에서 린산알루미니움은 결합제로 작용하여 부착세기를 높여준다고 볼수 있다.

리산의 작용원리 불수강판표면에서의 알루미나충 의 부착세기를 높이는 경우 린산의 역할을 보기 위하

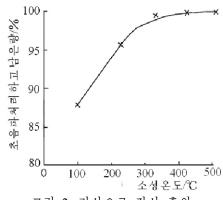


그림 2. 린산으로 적신 후의 소성온도와 알루미나층의 부착세기와의 관계 린산농도 40%

여 알루미나와 린산의 질량비가 1:0.5가 되도록 알루미나분말에 40% 린산수용액을 두고 사기절구에서 혼합하고 얻어진 반죽상태의 혼합물을 상온에서 건조한 다음 열무게분석 (TG, DTG)과 시차열분석(DTA)을 진행하였다.(그림 3)

그림 3에서 보는바와 같이 100~110℃에서의 질량감소는 혼합물에서의 물의 증발과 관련된것이고 그 이후부터 190℃까지에서의 질량감소는 반응

$$Al_2O_3 + 2H_3PO_4 \rightarrow 2AlPO_4 + 3H_2O$$

에 의한 탈수와 관련된것이라고 볼수 있다. 그 이후부터 500℃까지에서는 변화가 거의 없다.

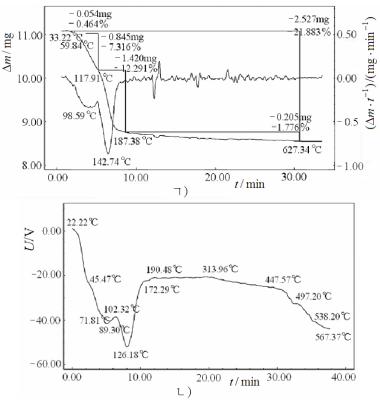


그림 3. 알루미나-린산혼합물의 열무게분석(기))과 시차열분석(L))결과

시차열분석(DTA)자료에서도 과정은 190℃이전에 다 끝나고 그 이후부터 500℃까지에서는 뚜렷한 변화가 없다는것을 보여준다.

이것은 소성온도와 부착세기와의 관계를 보여준 그림 2의 자료를 잘 설명해준다.

한편  $Al_2O_3$ -불수강판형담체를 40% 린산수용액으로 적시고 110 ℃에서 1h동안 건조한 시편과 이것을 다시 500 ℃에서 3h동안 소성한 시편의 XRD도형과 적외선흡수스펙트르를 측정하였다.(그림 4, 5)

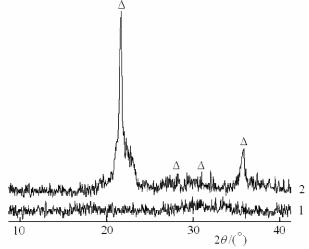


그림 4. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-불수강판형담체를 린산처리한 시편의 XRD도형 1-110℃에서 건조한것, 2-500℃에서 소성한것, Δ-AlPO<sub>4</sub>에 해당한 봉우리

그림 4에서 보는바와 같이 110℃에서 건조한 시편에서는 아무런 변화도 없이  $\gamma$ -알루미나의 무정형상태가 그대로 있다. IR흡수스펙트르에서는 1 118cm<sup>-1</sup>의 린산기에 해당한 흡수와 3 409cm<sup>-1</sup>부근의 OH에 해당한 넓은 흡수가 나타났다. 이 흡수는 린산의 OH와  $\gamma$ -알루미나의 표면 OH에 의한 흡수이다.

500℃에서 소성하면 XRD에서 보는것처럼 린산알루미니움이 본격적으로 생기며 그에 따라 IR흡수스펙트르의 OH에 의한 흡수도 훨씬 줄어들었다. 일부 남아있는 흡수는 2~알루미나의 표면 OH에 의한 흡수라고 볼수 있다.

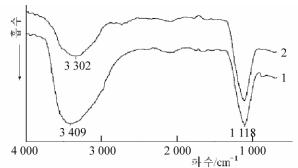


그림 5. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-불수강판형담체를 린산처리한 시편의 IR흡수스펙트르 1-110℃에서 건조한것, 2-500℃에서 소성한것

이상의 실험결과는  $Al_2O_3$ -불수강판형담체를 린산으로 처리할 때 다가산인 린산이 서로 린접한 알루미나립자의 표면들과 반응하여 린산알루미니움을 생성하면서 립자들을 결합시켜 그물구조를 이루고 일부 린산기들은 불수강판표면과 알루미나립자들을 결합시켜 견고한 피막을 형성하는 물림새로 부착세기를 높여준다는것을 보여준다.

#### 맺 는 말

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-불수강판형담체를 40% 린산수용액으로 적시고 110℃에서 1h동안 건조한 다음 300℃에서 3h동안 소성하면 알루미나층의 부착세기가 훨씬 높아진다.

다가산인 린산이 서로 린접한 알루미나립자들의 표면과 반응하여 린산알루미니움을 생성하면서 립자들을 결합시켜 그물구조를 이루고 일부 린산기들은 불수강판표면과 알루 미나립자들을 결합시켜 견고한 피막을 형성한다.

### 참 고 문 헌

- [1] 리종과 등; 화학과 화학공학, 2, 25, 주체107(2018).
- [2] 황수림 등; 화학과 화학공학, 4, 40, 주체106(2017).
- [3] H. M. Hawthorne; Surf. Coat. Tech., 176, 243, 2004.

주체107(2018)년 7월 5일 원고접수

# Improvement of Bond Strength of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Layer on Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Stainless Steel Plate Support by Phosphoric Acid

Choe Yong Gil, Ri Jong Gwa and Ri Son Il

The bond strength of alumina layer is remarkably improved when  $Al_2O_3$ -stainless steel plate support is soaked by 40% phosphoric acid, dried at  $110^{\circ}C$  for 1h and calcined at  $300^{\circ}C$  for 3h.

Key words: alumina, stainless steel, plate support, phosphoric acid